

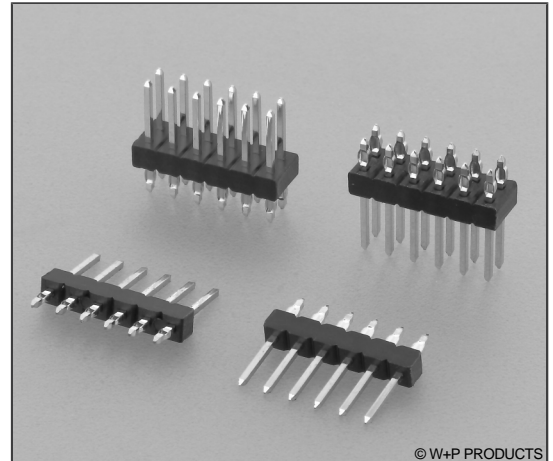
# 943PF / 944PF

Press-Fit Stiftheisen RM 2,54mm

Press-Fit Pin Header 2.54mm Pitch

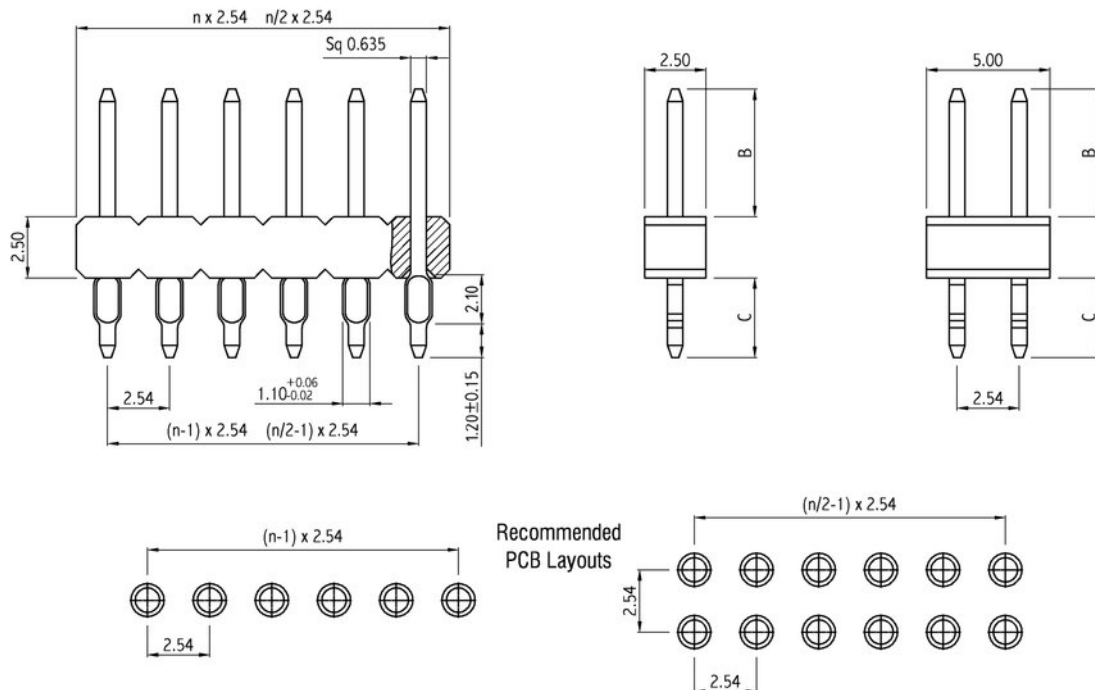
## Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1,3 ... 2,5µm)
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	500V <sub>AC</sub>
Test Voltage	500V <sub>AC</sub>
Nennstrom	3A
Current Rating	3A
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
Temperature Range	-40°C ... +105°C



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:  
Compatible Female Headers:  
153PF 154 157 159 160/162 349 624 etc.  
Weitere siehe Kapitel B  
Please see ch. B for more



### Einpressen über Stiftspitze.

### Press-in over pin tip.

Einpresszone s. Tech. Informationen.

See technical information for PressFit zones.

### Series\*

**944PF**

943PF Einreihig  
Single row  
944PF Zweireihig  
Double row

### Dimensions\*

**10**

10 B=5.20mm; C=3.30mm  
13 B=6.80mm; C=3.30mm  
14 B=8.10mm; C=3.30mm  
15 B=10.20mm; C=3.30mm  
16 B=13.00mm; C=3.30mm

### Contacts\*

**06**

01-40 Einreihig  
Single row  
02-80 Zweireihig  
Double row

### Plating\*

**00**

00 Vergoldet  
Gold plated  
50 Verzinkt  
Tin plated  
110 Steckbereich 0,25µm Au, Einpresszone Au flash  
Mating area 10µ" Au, PressFit area Au flash

Weitere Stiftlängen auf Anfrage. B<sub>max</sub>=20mm.

More pin length options on request. B<sub>max</sub>=20mm.

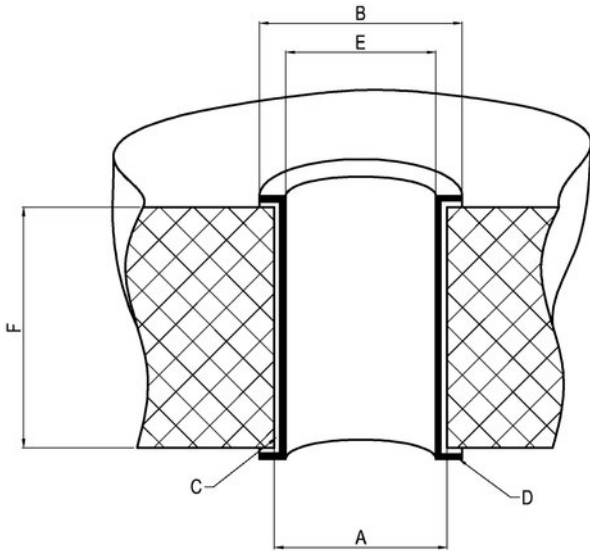
\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

# PressFit Lochdefinitionen

## PressFit Hole Definitions

### Empfohlene Maße der Einpresszonen unserer PressFit Stift- und Buchsenleisten

Recommended Dimensions of PressFit Through Holes



<b>A</b>	Bohrungs-Ø	Base Hole Ø
<b>B</b>	Ring-Ø	Ring Ø
<b>C</b>	Cu-Schicht	Cu Layer
<b>D</b>	Veredelung	Plating
<b>E</b>	Endloch-Ø	Final Hole Ø
<b>F</b>	Leiterplattendicke	PCB Thickness

Serie Series	RM / Pitch [mm]	A [mm]	B [mm]	C [µm]	D Option [µm]		E [mm]	F [mm]
					Sn	Au/Ni		
<b>943PF, 944PF</b> <b>943PFS,</b> <b>944PFS</b>	2,54	1,15±0,03	min. 1,35	min. 25	max. 1,5 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	1,00 <sup>+0,09</sup> <sub>-0,06</sub>	min. 1,60
<b>314PF</b>	2,00	0,89±0,03	min. 1,30	min. 30	max. 1,5 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	0,81±0,05	min. 1,60
<b>153PF</b>	2,54	1,15±0,03	min. 1,35	min. 25	5~15 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	1,00 <sup>+0,09</sup> <sub>-0,06</sub>	min. 1,60
<b>153PF-38</b>	2,54	1,15±0,03	min. 1,35	min. 25	5~15 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	1,00 <sup>+0,09</sup> <sub>-0,06</sub>	min. 2,50
<b>138PF</b>	2,54	1,00±0,03	min. 1,35	min. 25	max. 1,5 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	1,00±0,05	min. 1,60